

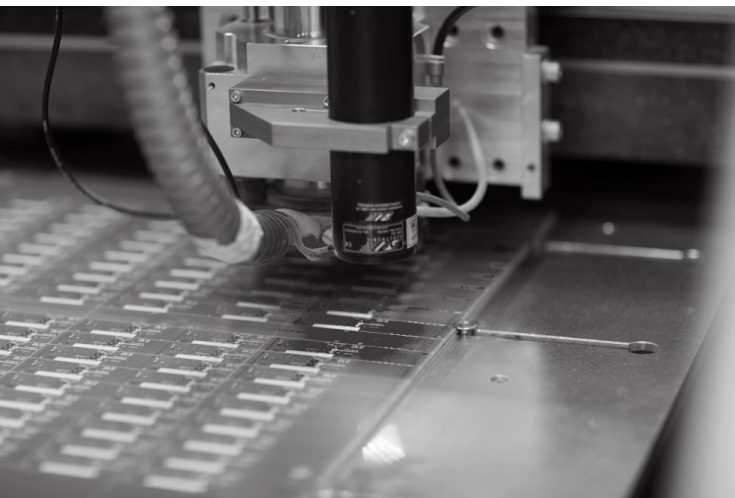
## [ Aufbau - und Verbindungstechnik ]

Für die Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte wie z.B. Smartphones sind heute Technologien zur Erhöhung der Integrationsdichte und Systemintegration Voraussetzung. Die Anforderungen an Komponenten wie Leiterplatten und somit an die Fertigung haben sich in den letzten Jahren extrem gewandelt.

Ziel des Workshop ist es, einen Überblick über die neusten Entwicklungen im Bereich des Packaging zu geben. Neben allgemeinen Trends in der Aufbau- und Verbindungstechnik werden auch spezielle Verfahren und Bereiche wie z.B. die Leiterplattenfertigung im Detail vorgestellt. Der Schwerpunkt wird in diesem Jahr nicht nur auf die optischen Anwendungen sondern auch auf die elektronischen Aspekte der AVT gelegt.

So wird z.B. das Drucksintern als Verfahren für leistungselektronische Komponenten aber auch das Design und der Aufbau von optoelektronischen Leiterplatten vorgestellt .

Der Workshop richtet sich sowohl an Entwickler als auch an Anwender aus den Bereichen Laser Packaging, Optik, Elektronik und Mikrosystemtechnik.



## [ Anfahrt ]

**ILFA Industrieelektronik und  
Leiterplattenfertigung aller Art GmbH**  
Lohweg 3  
30559 Hannover

Hier geht es zu [google maps](#):



## [ Veranstalter ]

**PhotonicNet GmbH**  
Dr.-Ing. Thomas Fahlbusch  
Tel.: 0511 / 277-1640  
fahlbusch@photonicnet.de

## [ in Kooperation mit ]

**ILFA GmbH**  
Dr. Andreas Gombert  
Tel.: 0511-959 55 3047  
A.gombert@ilfa.de

# Photonic-Net

Innovationsnetz Optische Technologien

IN KOOPERATION MIT:



**AVT**  
**Aufbau- und  
Verbindungstechnik**

**[ Hannover  
18. Oktober 2017 ]**



### [ 17.10.2017 ]

#### Abendveranstaltung

**Get Together Abendessen im Restaurant Besitos, Hannover**

19:30 Uhr

#### Mittagspause

12:10 Uhr

**Einsatz von Robotern in der aktiven Montage von elektro-optischen Komponenten**

*Torsten Vahrenkamp*  
ficonTEC Service GmbH, Achim

13:15 Uhr

### [ 18.10.2017 ]

#### Begrüßung der Teilnehmer

*Dr.-Ing. Thomas Fahlbusch*  
PhotonicNet GmbH, Hannover

09:30 Uhr

**Design and Packaging of Electro-Optical Circuit Boards**

*Daniel Weber*  
Fraunhofer - Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin

13:45 Uhr

#### Trends und Herausforderungen der AVT

*Prof. Dr. Jürgen Wilde*  
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK),  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

09:40 Uhr

#### Kaffeepause

14:15 Uhr

#### Entwicklungstrends in der Leiterplattentechnologie

*Dr. Andreas Gombert*  
ILFA Industrieelektronik und Leiterplattenfertigung aller Art GmbH, Hannover

10:10 Uhr

**Gedruckte Polymer-Lichtwellenleiter**

*Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer*  
Institut für Transport- und Automatisierungstechnik (ITA)  
Leibniz Universität Hannover

14:45 Uhr

#### Kaffeepause

10:40 Uhr

**Inspektionssysteme für elektronische und elektro-optische Leiterplatten**

*Volker Pape*  
Viscom AG, Hannover

15:15 Uhr

#### Drucksintern aktiver und passiver leistungselektronischer Komponenten

*Prof. Dr. Ronald Eisele*  
Institut für Mechatronik, Hochschule für angewandte Wissenschaften Kiel

11:10 Uhr

Besichtigung der ILFA GmbH

15:45 Uhr

#### Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser in der elektronischen Baugruppenfertigung

*Andreas Kraus*  
Kraus Hardware GmbH, Großostheim

11:40 Uhr

**Ende der Veranstaltung**

ca. 17:00 Uhr

**Verbindliche Anmeldung bitte bis spätestens 09. Oktober an:**

**Fax-Nr.: 0511 / 277 16-50 oder**

**ONLINE oder**

**E-Mail an: [Veranstaltung@photonicnet.de](mailto:Veranstaltung@photonicnet.de)**

An dem Workshop nehme ich teil

Am Abendessen (17.10.17) nehme ich teil

Titel, Vorname, Name

Firma / Institution

Straße

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Mitglied im Innovationsnetz OT

Datum / Unterschrift

**Veranstaltungsort:**

ILFA Industrieelektronik und  
Leiterplattenfertigung aller Art GmbH  
Lohweg 3, 30559 Hannover

**Teilnehmergebühr (inkl. Abendessen):**

290,00 € (zzgl. 19% MwSt.).  
Für Mitglieder der Innovationsnetze Optische Technologien  
230,00 € (zzgl. 19% MwSt.).

Mit Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.